

一、系爭專利 1 (M500772) 技術分析：

(一)技術內容：

一種用於電鍍裝置之內蓋導電結構，與一電鍍載體的複數導電元件接觸，該內蓋導電結構包含：一環形內蓋；及至少三導電片體，間隔環設於該環形內蓋的底部；其中，當該環形內蓋蓋設於該電鍍載體時，各該導電片體對應至少二導電元件的端點。藉此，本創作之內蓋導電結構能防止因部分的導電元件壞損而無法導電的情況發生；此外，該內蓋導電結構的製造成本低且結構強。(參系爭專利 1 摘要)。

(二)主要圖式：

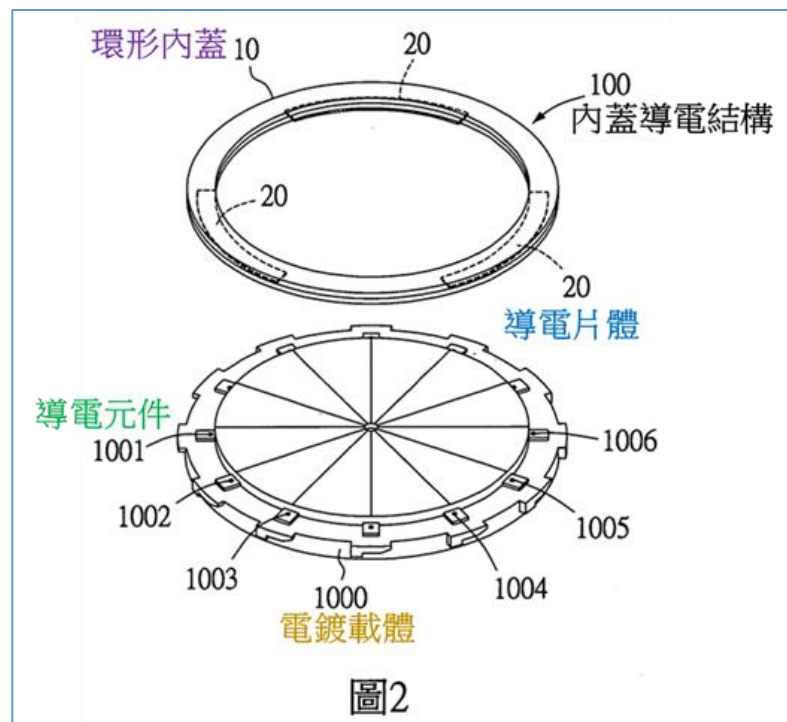


圖 2 為內蓋導電結構與電鍍載體之示意圖。

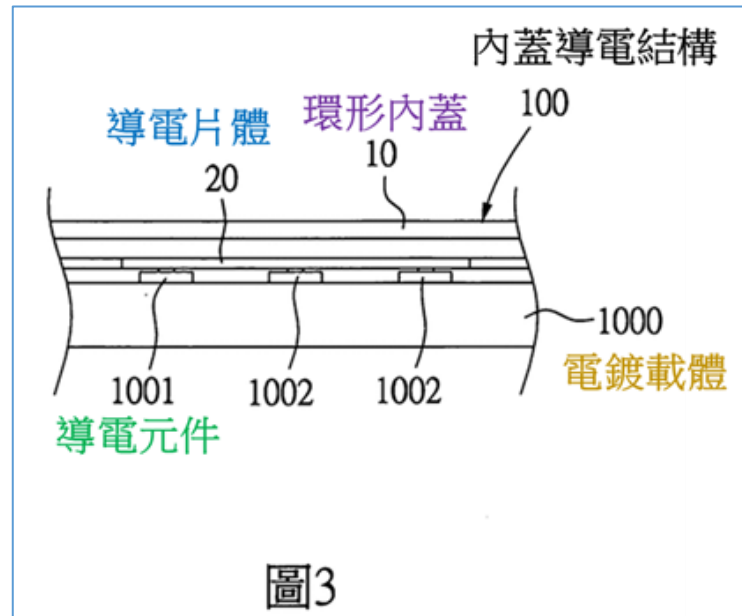


圖 3 為內蓋導電結構與電鍍載體組合後之局部剖面圖。

(三)申請專利範圍：

系爭專利 1 申請專利範圍共計 4 項，其中請求項 1 為獨立項，請求項 2 至 4 為直接或間接依附於請求項 1 之附屬項，其內容如下：

(第 1 項)一種用於電鍍裝置之內蓋導電結構，與一電鍍載體的複數導電元件接觸，該內蓋導電結構包含：(1A)一環形內蓋；及(1B)至少三導電片體，間隔環設於該環形內蓋的底部；(1C)其中，當該環形內蓋蓋設於該電鍍載體時，各該導電片體對應至少二導電元件的端點。(1D)

(第 2 項)如請求項 1 所述之內蓋導電結構，其中，該等導電片體係分別凹設於該環形內蓋的底部。

(第 3 項)如請求項 1 或 2 所述之內蓋導電結構，其中，該等導電片體較佳為四片至六片。

(第 4 項)如請求項 3 所述之內蓋導電結構，其中，該等導電片體更佳為四片。

二、系爭專利 2 (M500773) 技術分析：

(一)技術內容：

一種用於電鍍裝置的卡固結構，以將電鍍載體與上蓋卡固，卡固結構包含環設於電鍍載體邊緣的卡固部、環設於上蓋內壁邊緣的卡固部及抵頂定位件，卡固部分別具有卡固本體及導引斜面，卡固本體與電鍍載體的載面水平，導引斜面設於卡固本體的一端；抵頂定位件凸設於電鍍載體之卡固本體的另一端；其中，當旋轉上蓋時，上蓋的卡固本體經由導引斜面導引，使上蓋的卡固本體被抵頂定位件抵頂，以使電鍍載體與上蓋相互卡固。藉此，防止電鍍載體與上蓋卡固時，因過度旋緊而造成其結構崩壞或造成待鍍物壓壞。(參系爭專利 2 摘要)。

(二)主要圖式：

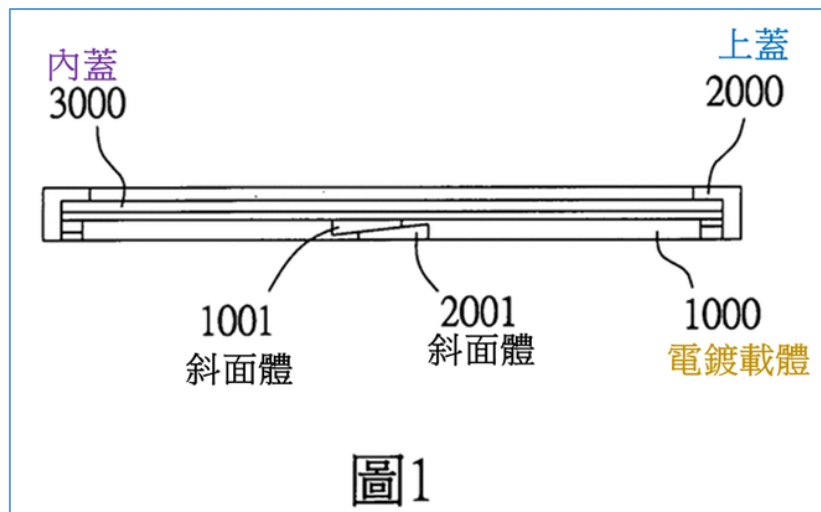


圖 1 為習知的電鍍裝置之電鍍載體與上蓋的卡固示意圖。

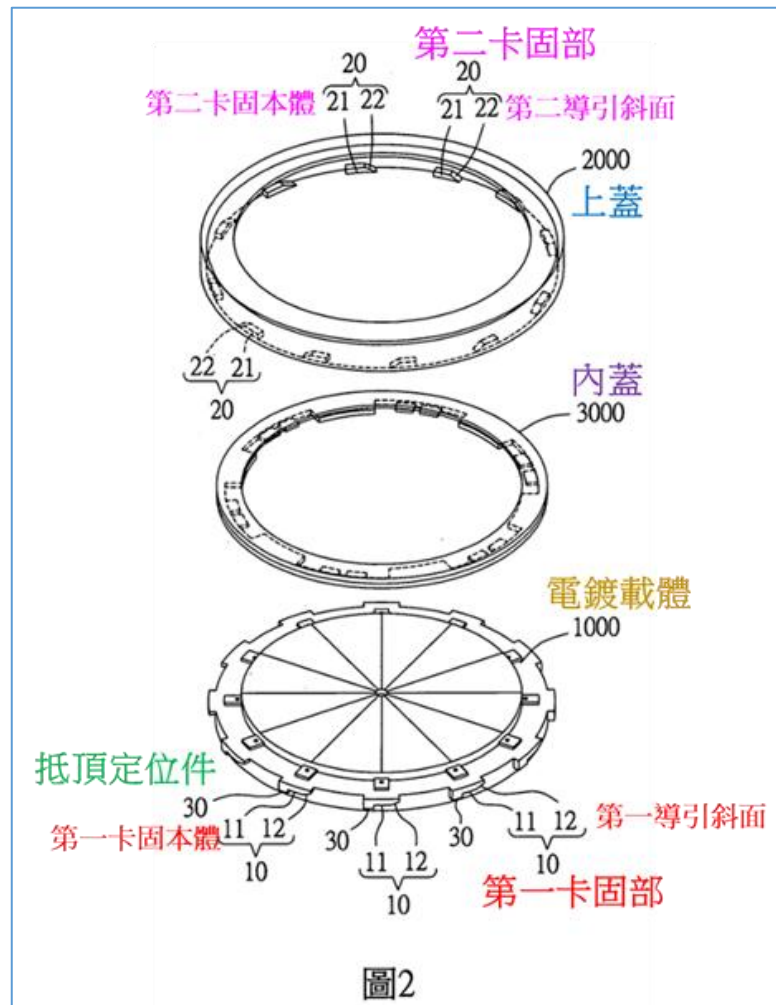


圖 2 為用於電鍍裝置之卡固結構的第一實施例之示意圖。

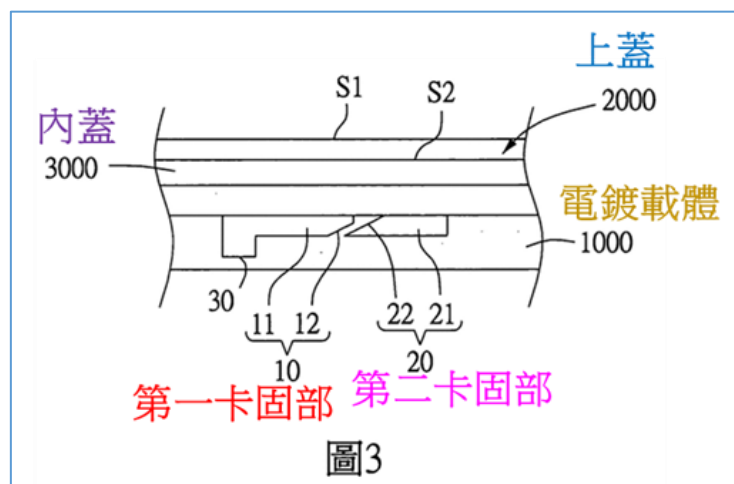


圖 3 為圖 2 中之電鍍載體與上蓋進行卡固時的作動示意圖。

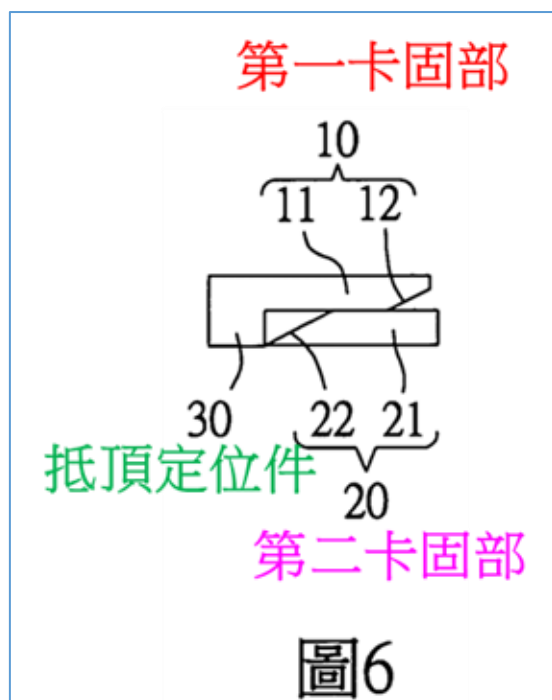


圖 6 為圖 2 中之電鍍載體與上蓋進行卡固時的作動示意圖。

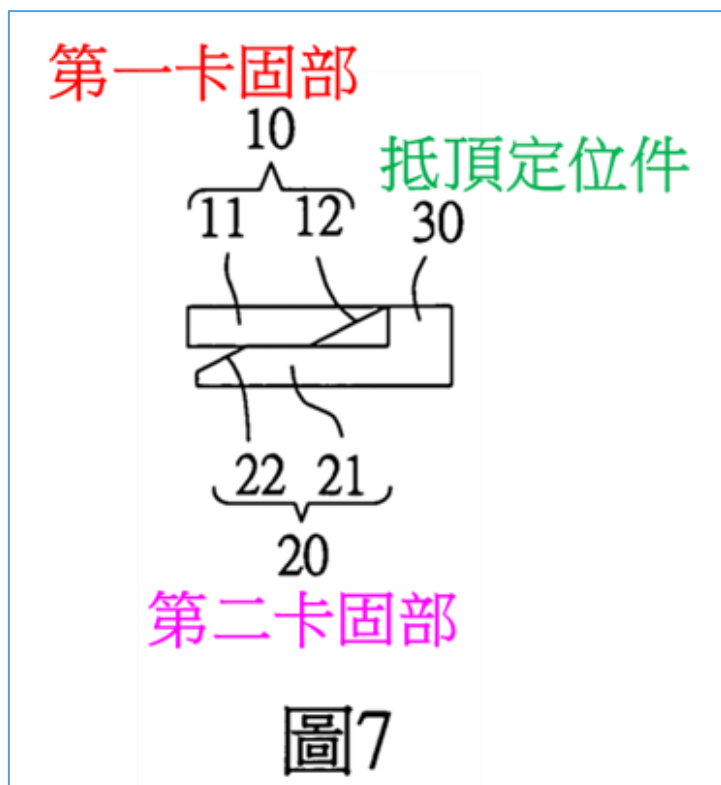


圖 7 為電鍍裝置之卡固結構的第二實施例之示意圖。

(三)申請專利範圍：

系爭專利 2 申請專利範圍共計 5 項，其中請求項 1 為獨立項，請求項 2 至 5 為直接或間接依附於請求項 1 之附屬項，其內容如下：

(第 1 項)一種用於電鍍裝置的卡固結構，以將該電鍍裝置的一電鍍載體與一上蓋相互卡固，該卡固結構包含：(1A) 複數第一卡固部，環設於該電鍍載體的邊緣，各該第一卡固部具有：一第一卡固本體，與該電鍍載體的一載面水平；及一第一導引斜面，設置於該第一卡固本體的一端，以使該第一卡固本體成為梯形體；(1B) 複數第二卡固部，環設於該上蓋的內壁邊緣，各該第二卡固部具有：一第二卡固本體，與該上蓋的一蓋面水平；及一第二導引斜面，設置於該第二卡固本體的一端，並與該第一導引斜面水平，以使該第二卡固本體成為梯形體；以及(1C) 複數抵頂定位件，凸設於各該第一卡固本體的另一端或各該第二卡固本體的另一端；(1D) 其中，當旋轉該上蓋時，各該第二卡固部的第二導引斜面與各該第一卡固部的第一導引斜面相互導引，各該抵頂定位件抵頂各該第二卡固本體或各該第一卡固本體，以使該電鍍載體與該上蓋相互卡固(1E)。

(第 2 項)如請求項 1 所述之卡固結構，其中，當各該抵頂定位件凸設於各該第一卡固本體的另一端時，各該抵頂定位件與各該第一卡固本體為一體成型。

(第 3 項)如請求項 2 所述之卡固結構，其中，各該抵頂定位件分別與各該第一卡固本體垂直。

(第 4 項)如請求項 1 所述之卡固結構，其中，當各該抵頂定位件凸設於各該第二卡固本體的另一端時，各該抵頂定位件與各該第二卡固本體為一體成型。

(第 5 項)如請求項 4 所述之卡固結構，其中，各該抵頂定位件分別與各該第二卡固本體垂直。

三、系爭專利 3 (M502698) 技術分析：

(一)技術內容：

一種用於電鍍載體之導電結構，包含：一導電引導元件，設置於一電鍍載體的底部，並電連接於複數電源線；複數導電分散元件，設置於該電鍍載體的底部，各該導電分散元件的一端電連接於該導電引導元件；及複數導電連接元件，設置於該電鍍載體的頂部，並分別電連接於各該導電分散元件的另一端。藉此，本創作之導電結構將該等電源線所提供的電力均勻分散傳輸至各該導電連接元件（參系爭專利 3 摘要）。

(二)主要圖式：

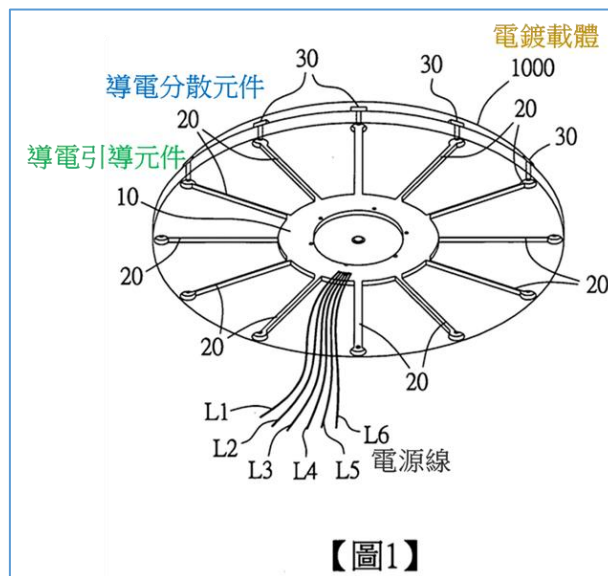


圖 1 為用於電鍍載體之導電結構的第一實施例之示意圖。

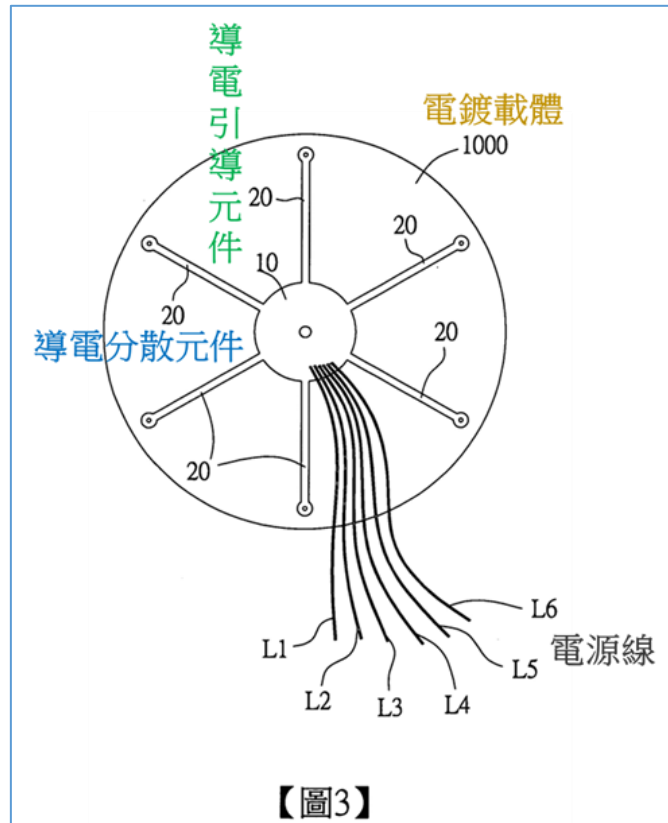


圖 3 為用於電鍍載體之導電結構的第二實施例之仰視圖。

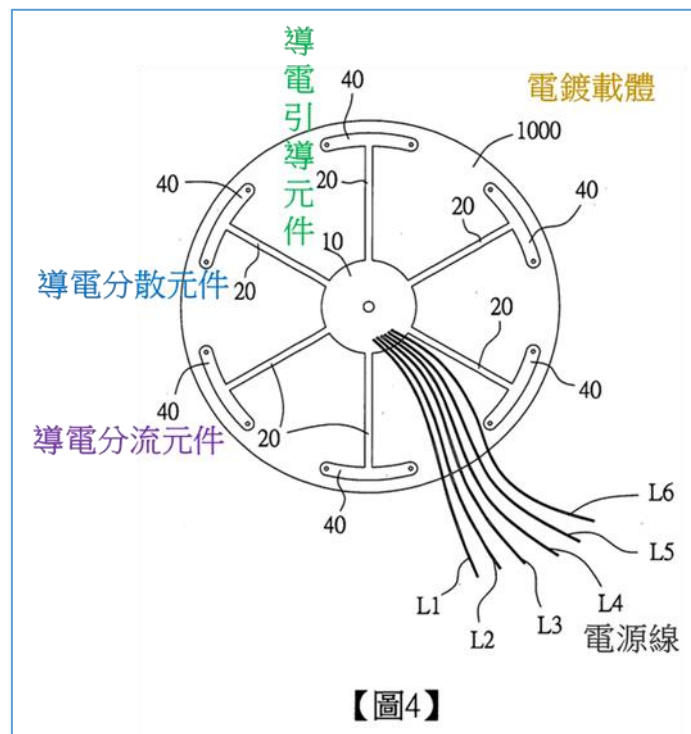


圖 4 為用於電鍍載體之導電結構的第三實施例之仰視圖。

(三)申請專利範圍：

系爭專利 3 申請專利範圍共計 6 項，其中請求項 1 為獨立項，請求項 2 至 6 為直接或間接依附於請求項 1 之附屬項，其內容如下：

(第 1 項)一種用於電鍍載體之導電結構，包含：(1A)一導電引導元件，設置於一電鍍載體的底部，並電連接於複數電源線；(1B)複數導電分散元件，設置於該電鍍載體的底部，各該導電分散元件的一端電連接於該導電引導元件；及(1C)複數導電連接元件，設置於該電鍍載體的頂部，並分別電連接於各該導電分散元件的另一端。(1D)

(第 2 項)如請求項 1 所述之導電結構，其中，該導電引導元件與該等導電分散元件為一體成型。

(第 3 項)如請求項 1 或 2 所述之導電結構，更包含複數導電分流元件，分別設置於各該導電分散元件的另一端，且各該導電連接元件分別電連接於各該導電分流元件的兩端。

(第 4 項)如請求項 3 所述之導電結構，其中，該等導電分流元件與該等導電分散元件為一體成型。

(第 5 項)如請求項 4 所述之導電結構，其中，各該導電分流元件的兩端分別電連接二個導電連接元件。

(第 6 項)如請求項 3 所述之導電結構，其中，各該導電分流元件的兩端分別電連接二個導電連接元件。

四、系爭專利 4 (M512594) 技術分析：

(一)技術內容：

一種導電固定結構，用於固定一晶圓電鍍夾持構件，並將該晶圓電鍍夾持構件電連接於一基座，該導電固定結構包含：一導電座，其中央固定該晶圓電鍍夾持構件，且該導電座架設於該基座；及至少二導電塊，分別設置於該導電座之相對兩側邊，且該等導電塊分別電連接於該晶圓電鍍夾持構件；其中，該等導電塊用於分別電接觸於該基座的複數導電彈片。本創作導電固定結構能有效地降低該等導電塊壞損，並利於更換；此外，藉由該等導電塊電接觸於該等導電彈片的同時，能刮去該等導電塊因長時間使用而產生的氧化層，以延長該等導電塊的使用壽命（參系爭專利 4 摘要）。

(二)主要圖式：

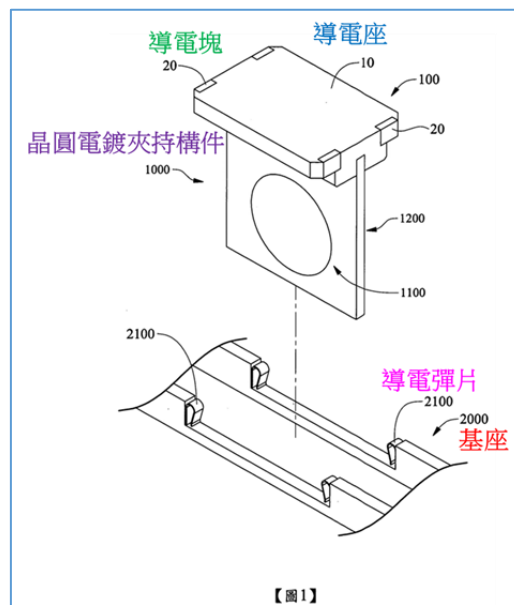


圖 1 為導電固定結構將一晶圓電鍍夾持構件電連接於一基座的分解圖。

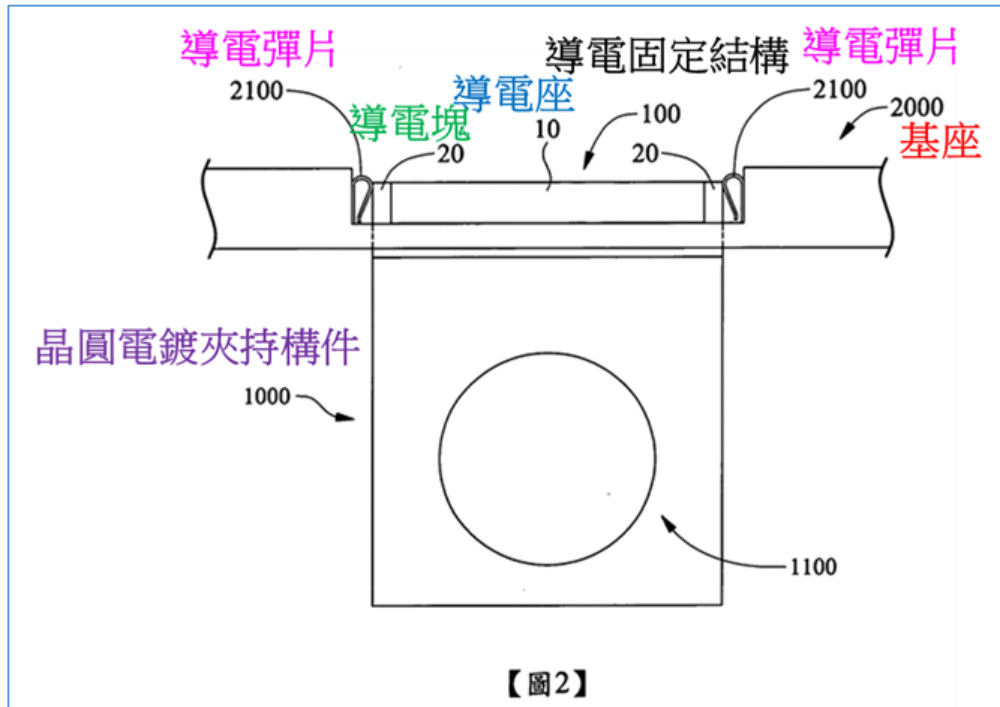


圖 2 導電固定結構將該晶圓電鍍夾持構件電連接於該基座的剖面圖。

(三)申請專利範圍：

系爭專利 4 申請專利範圍共計 5 項，其中請求項 1 為獨立項，請求項 2 至 5 為直接或間接依附於請求項 1 之附屬項，其內容如下：

(第 1 項)一種導電固定結構，用於固定一晶圓電鍍夾持構件，並將該晶圓電鍍夾持構件電連接於一基座，該導電固定結構包含：(1A) 一導電座，其中央固定該晶圓電鍍夾持構件，且該導電座架設於該基座；及 (1B) 至少二導電塊，分別設置於該導電座之相對兩側邊，且該等導電塊分別電連接於該晶圓電鍍夾持構件；(1C) 其中，該等導電塊用於分別電接觸於該基座的複數導電彈片。(1D)

(第 2 項)如請求項 1 所述之導電固定結構，其中，該等導電塊為四個，於該導電座之相對兩側邊分別設置兩個導電塊。

(第 3 項)如請求項 2 所述之導電固定結構，其中，該等導電塊係對稱排列。

(第 4 項)如請求項 1 所述之導電固定結構，其中，該等導電塊係對稱排列。

(第 5 項)如請求項 1 至 4 中任一項所述之導電固定結構，其中，該等導電塊係凹設於該導電座之相對兩側邊。